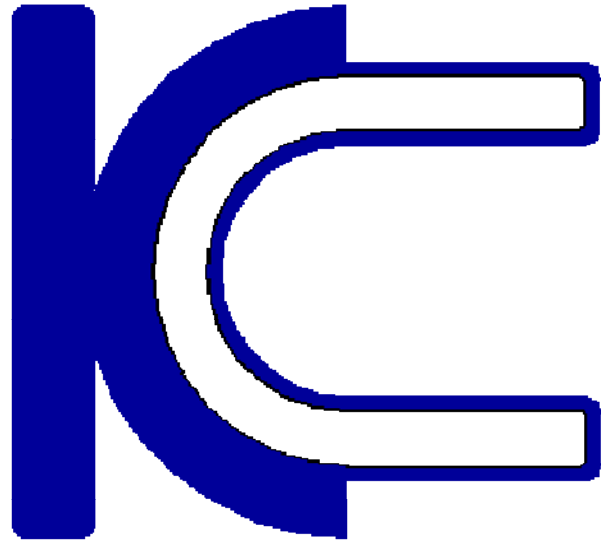


鈞寶電子工業股份有限公司
KING CORE ELECTRONICS INC.



您最佳電磁波干擾對策夥伴

健康、快樂，充滿未來遠景的公司



公 司 概 況

- 成立日期：1986年11月29日
- 生產基地：平鎮廠，4,107坪(13,700M²)
蘇州廠，17,000坪(56,700M²)
- 資 本 額：新台幣 8.67億元(2019/6/30)
- 董 事 長：楊正利
- 總 經 理：陳震漢
- 員 工：~400人

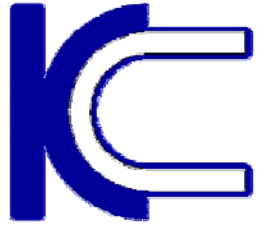




公 司 沿 革

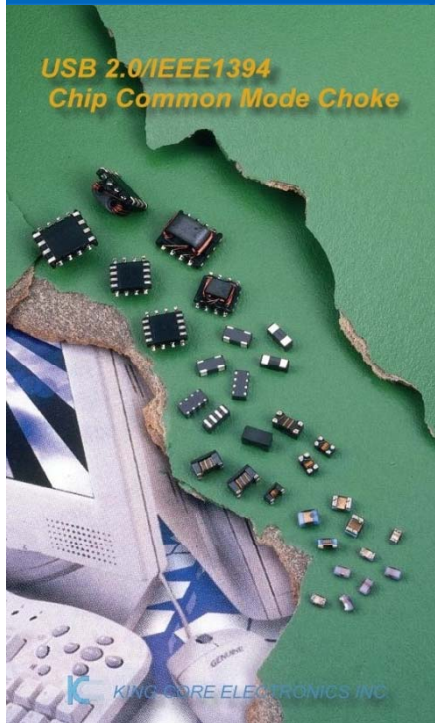
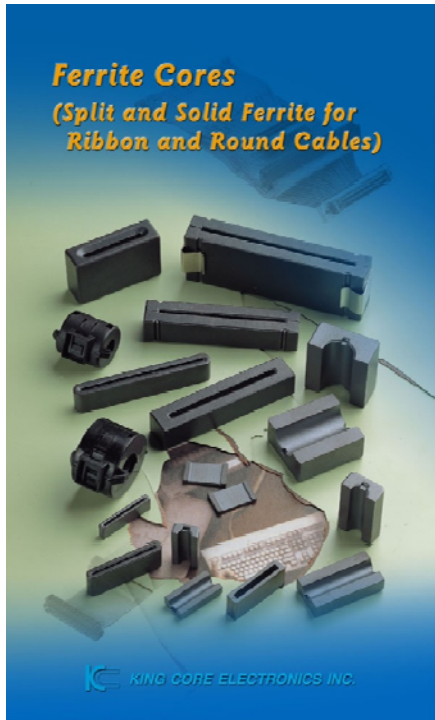
- ✓ 1986年：公司成立，生產鎳鋅系鐵氧體磁芯
- ✓ 1995年：成立“積層晶片廠”
- ✓ 1996年：ISO 9000 認證通過
- ✓ 1999年：鈞寶電子蘇州廠設立
- ✓ 2001年：財政部證期會核准上櫃掛牌（股票代號：6155）
- ✓ 2003年：成立“精密線圈事業部”
- ✓ 2006年：證券交易所上櫃轉上市審查通過
- ✓ 2008年：ISO 14000 認證通過
- ✓ 2009年：Sony GP 認證通過
- ✓ 2009年：IECQ QC080000 認證通過
- ✓ 2012年：TS16949 認證通過
- ✓ 2013年：投入“高頻(GHz)共模濾波元件”開發
- ✓ 2014年：投入“微型大功率電感”開發
- ✓ 2016年：平鎮廠太陽能設置發電：417.6KW，50萬度/年
- ✓ 2017年：投入“LTCC BPF, LPF, Diplexer”開發





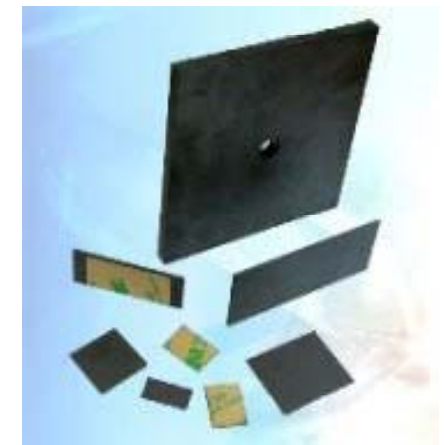
鼓 勵 與 肯 定

- 1997年：經濟部中小企業處【資訊化示範企業】表揚狀
- 1999年：全國優良企業選拔之傑出「小巨人獎」
- 2000年：經濟部工業局頒發「工業減廢及污染防治」成果卓著獎
- 2000年：仁寶電腦環保中衛體系優良獎
- 2001年：天下雜誌【全國成長最快100家中堅企業】調查，第27名
- 2001年：公司創立人楊正利董事長榮獲全國【創業楷模】
- 2002年：華碩電腦頒發【2001最佳供應商】獎座
- 2002年：榮膺遠見雜誌【全國資訊產業200強】第24名
- 2005年：勤業眾信(Deloitte)評鑑為【2004亞洲科技公司前500強】
- 2007~2018年：Hitachi 頒發【最佳供應商】獎

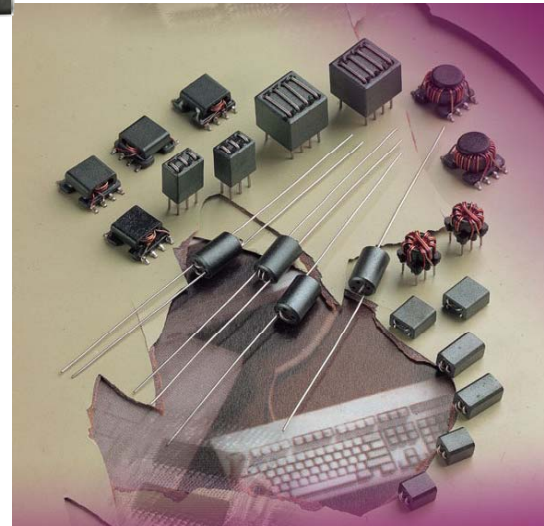


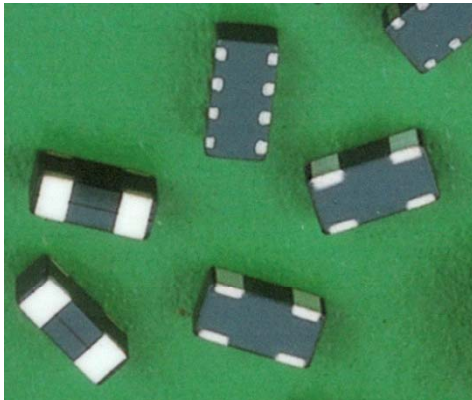
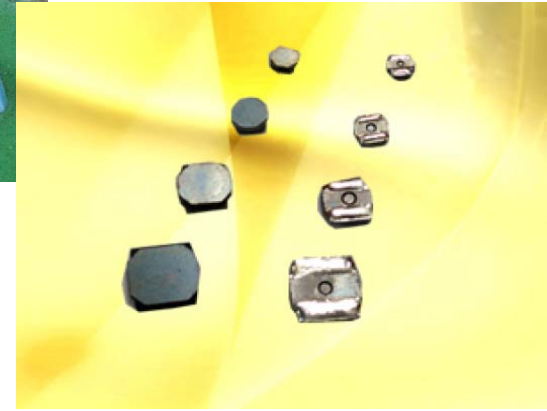
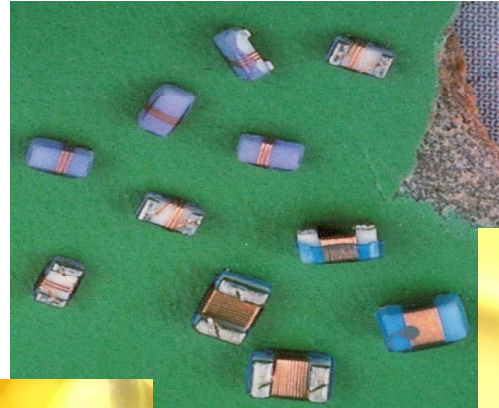
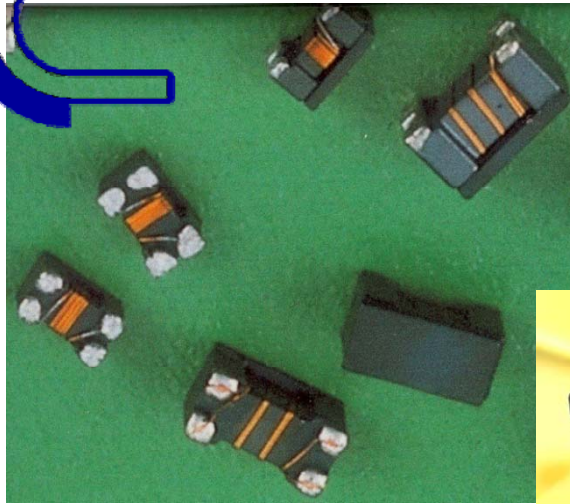
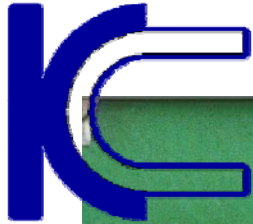
K C 主要產品

- 電磁波干擾抑制用磁環
 - 500 tons/ month
- SMT 積層式晶片磁珠及電感
 - 300~500 kkpcs/ month(0402/0603)
- 繞線式SMT電感及抗流線圈
 - 100~150 kkpcs/ month
- 鐵氧體吸波材
 - 1 kkpcs/ month



2019/10/22



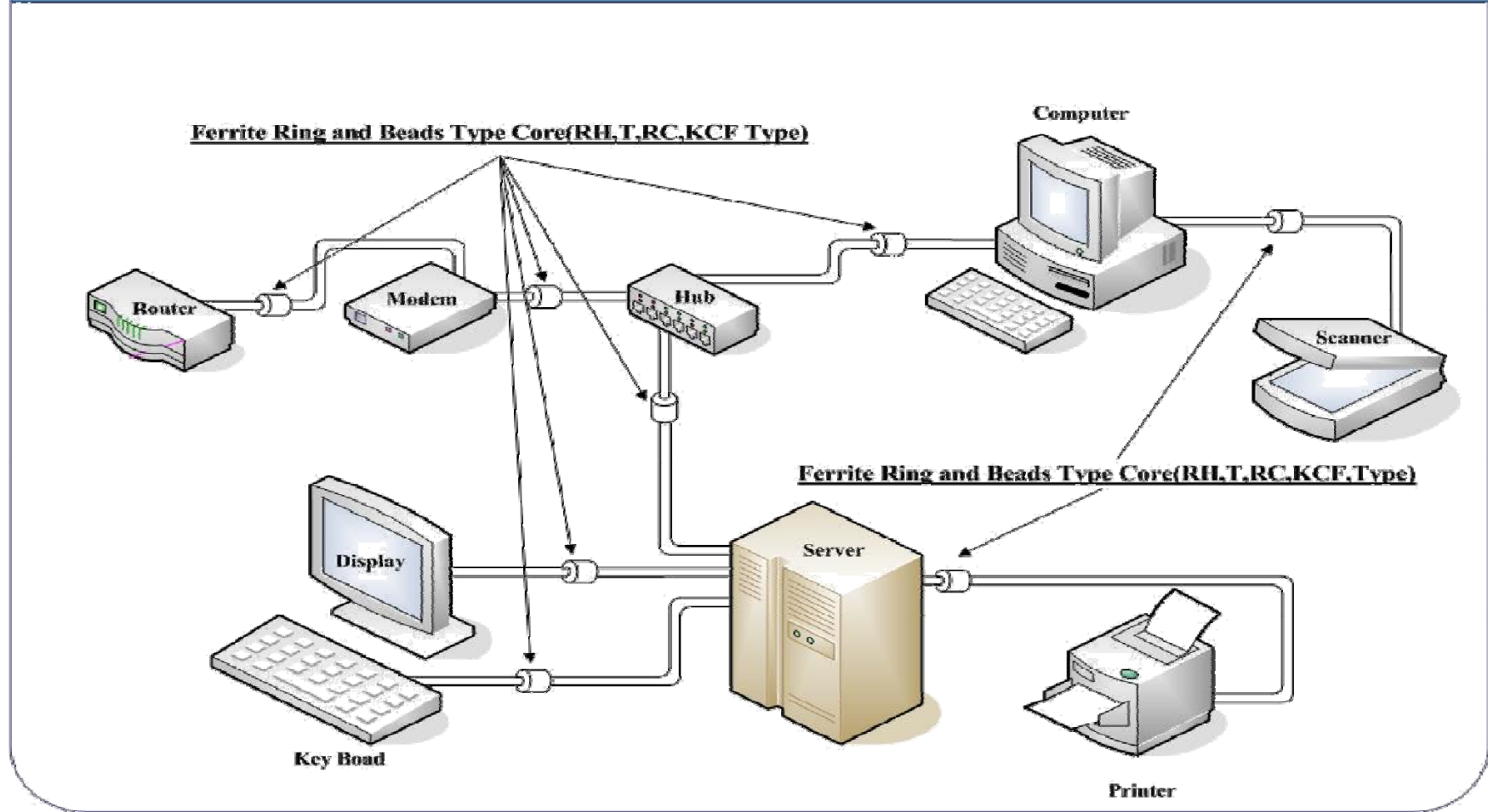


2019/10/22



KC EMI Suppression Core在3C產品上的應用範例

An Illustration of How to Apply EMI Ferrite Core on Cable





KC EMI Filter在PCB上的應用範例

CPU data bus之對策

可:採用FBM-10 series
10 - 70 ohm bead

Comm 1, 2 介面之EMI
對策

可:採用FBM-10 series
70 - 220 ohm bead

Modem 電話介面之EMI
對策

可:採用FBM-11 series
600 - 1000 ohm bead

IC 電源 Vcc+ in之對策

可:採用FBM...A series
耐大電流 120 ohm bead

Print Port介面之EMI
對策

可:採用FBM-11 series
70 - 300 ohm bead

DC in 電源input之對策

可:採用FBM...A series
耐大電流 120 ohm bead

Video out or LVDS介面之
EMI對策

可:採用FBM-10 series
30 - 120 ohm bead

Clock Generator 之對策

可:採用FBM-10 series
10 - 70 ohm bead

IEEE 1394 or USB or LAN
介面之EMI對策

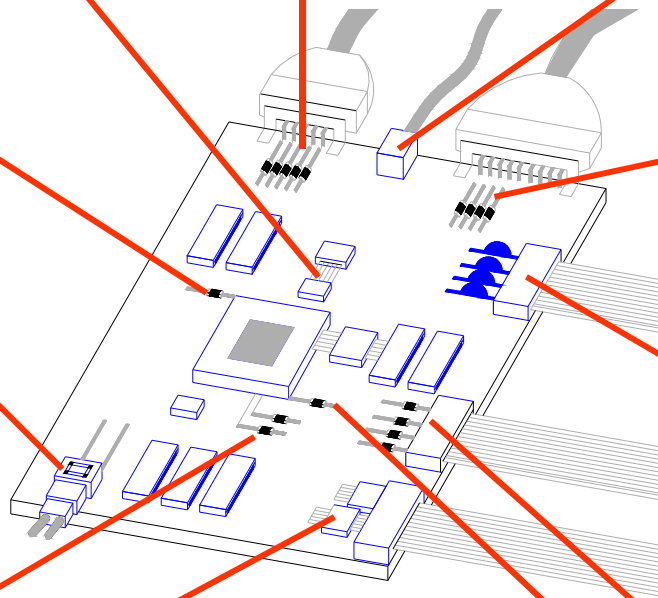
可:採用WCM series 90-
220 ohm common choke

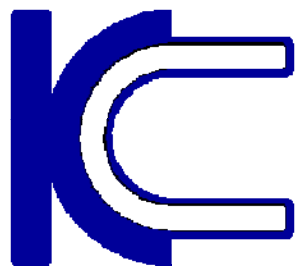
IC Grounding 接地之對策

可:採用FBM-11 series
120 - 600 ohm bead

HDD or CD-ROM介面之
EMI對策

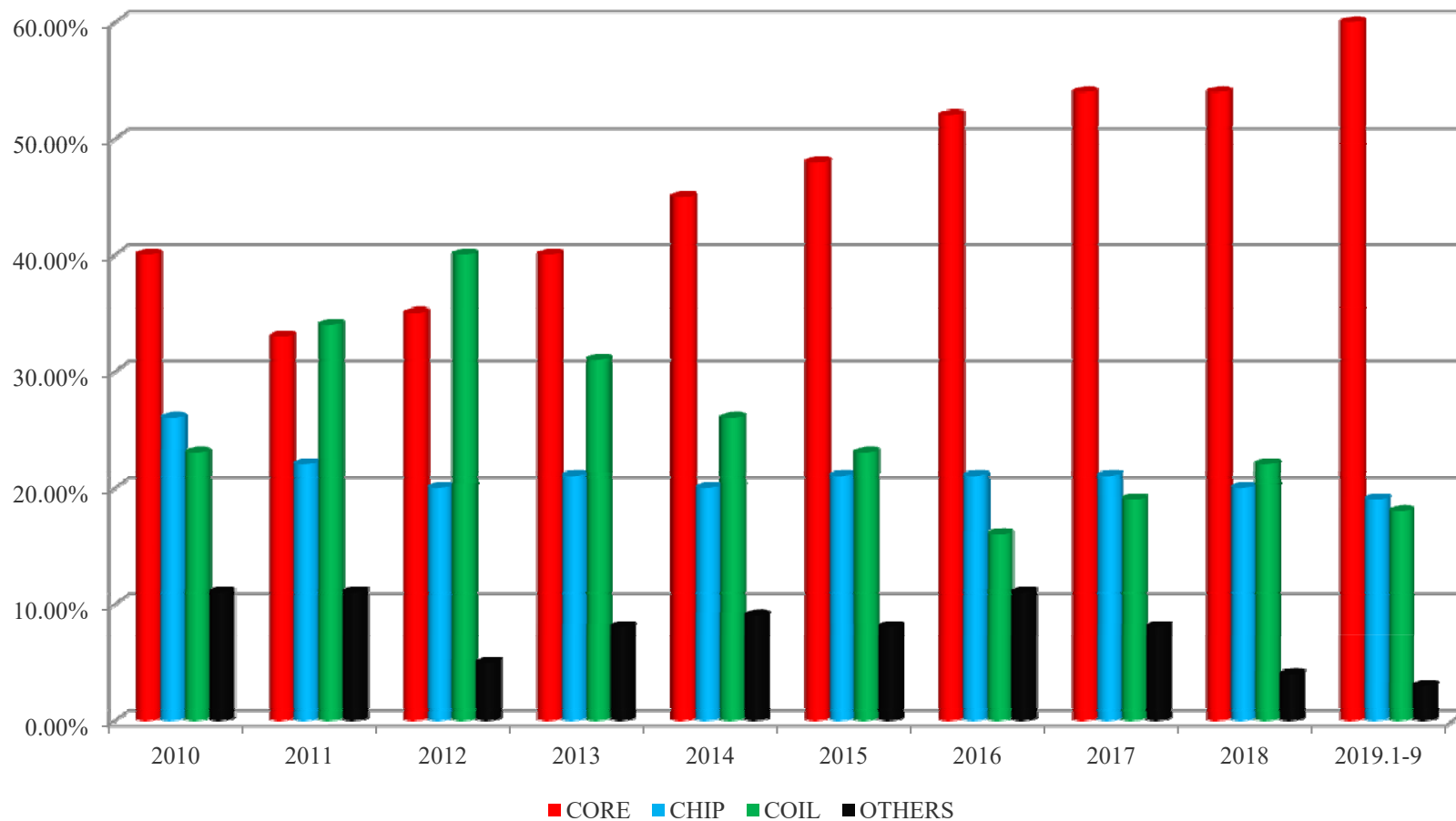
可:採用FBM-10 series
10 - 70 ohm bead

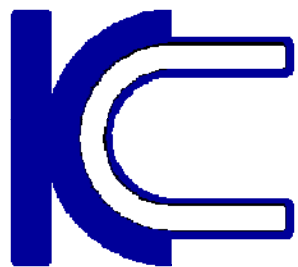




產品類別佔比

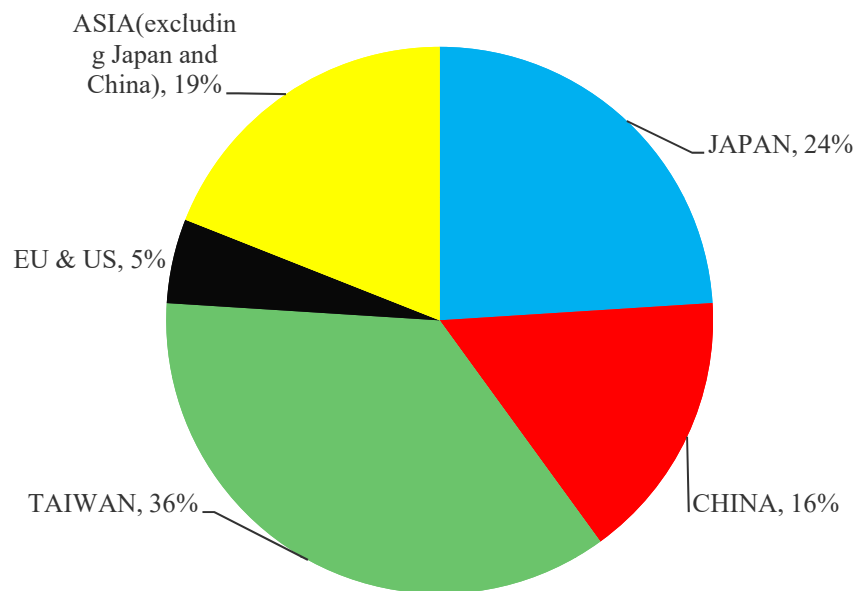
2019.1~9
CORE : 60%
CHIP : 19%
COIL : 18%
OTHERS : 3%



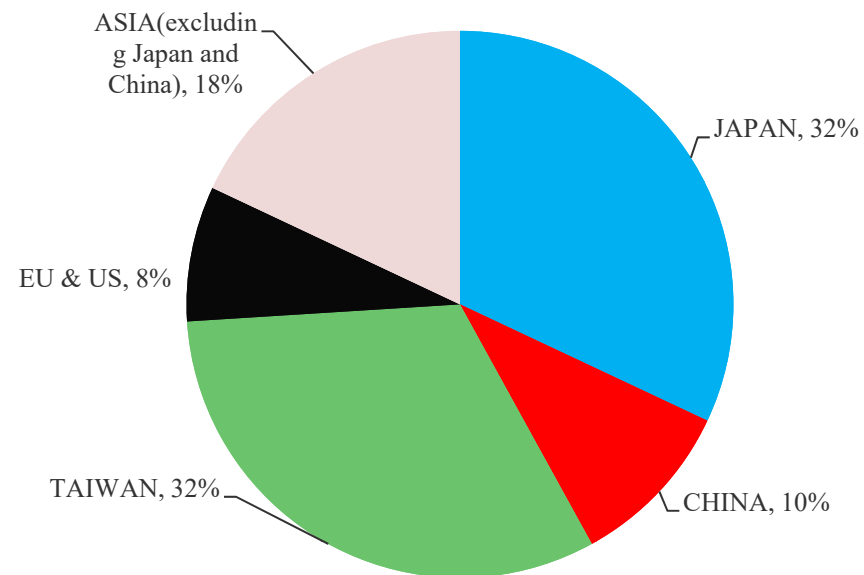


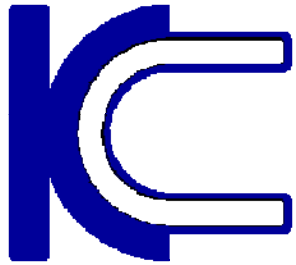
客戶區域佔比

2018

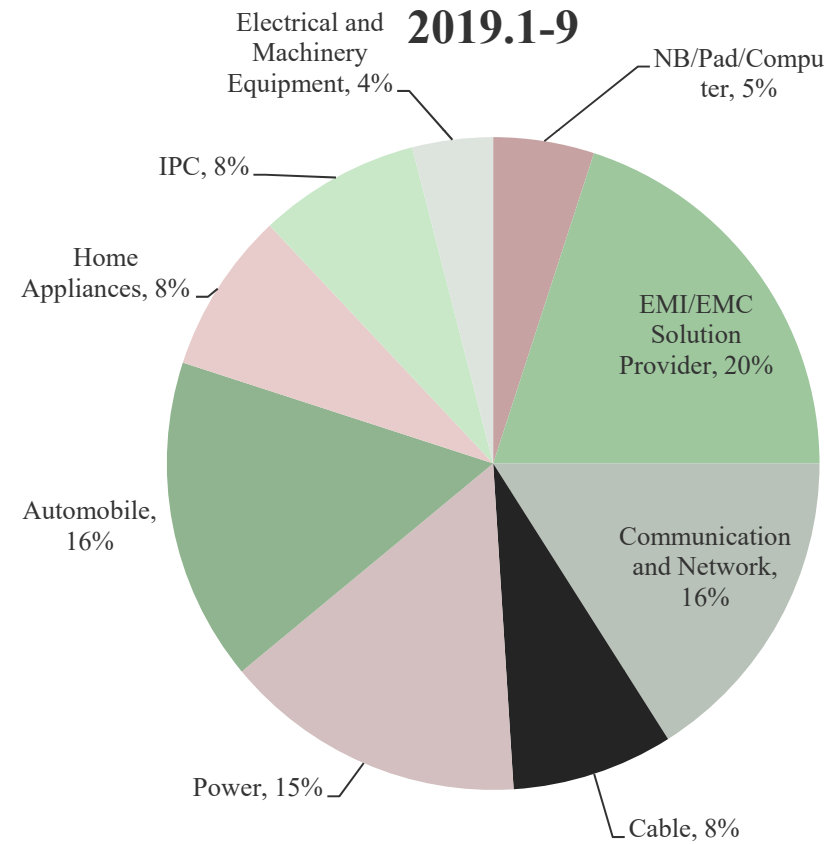
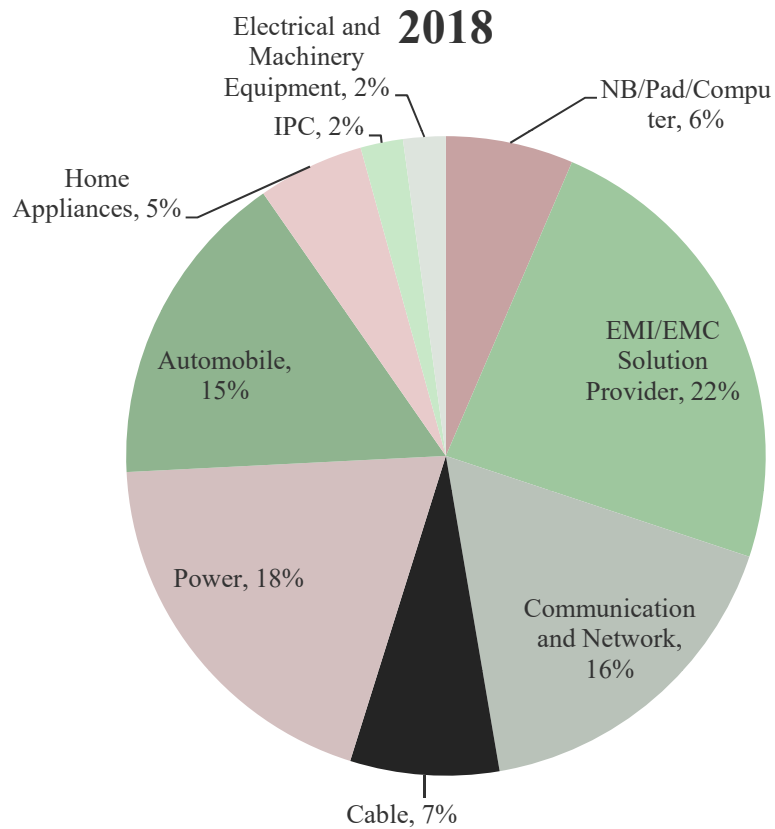


2019



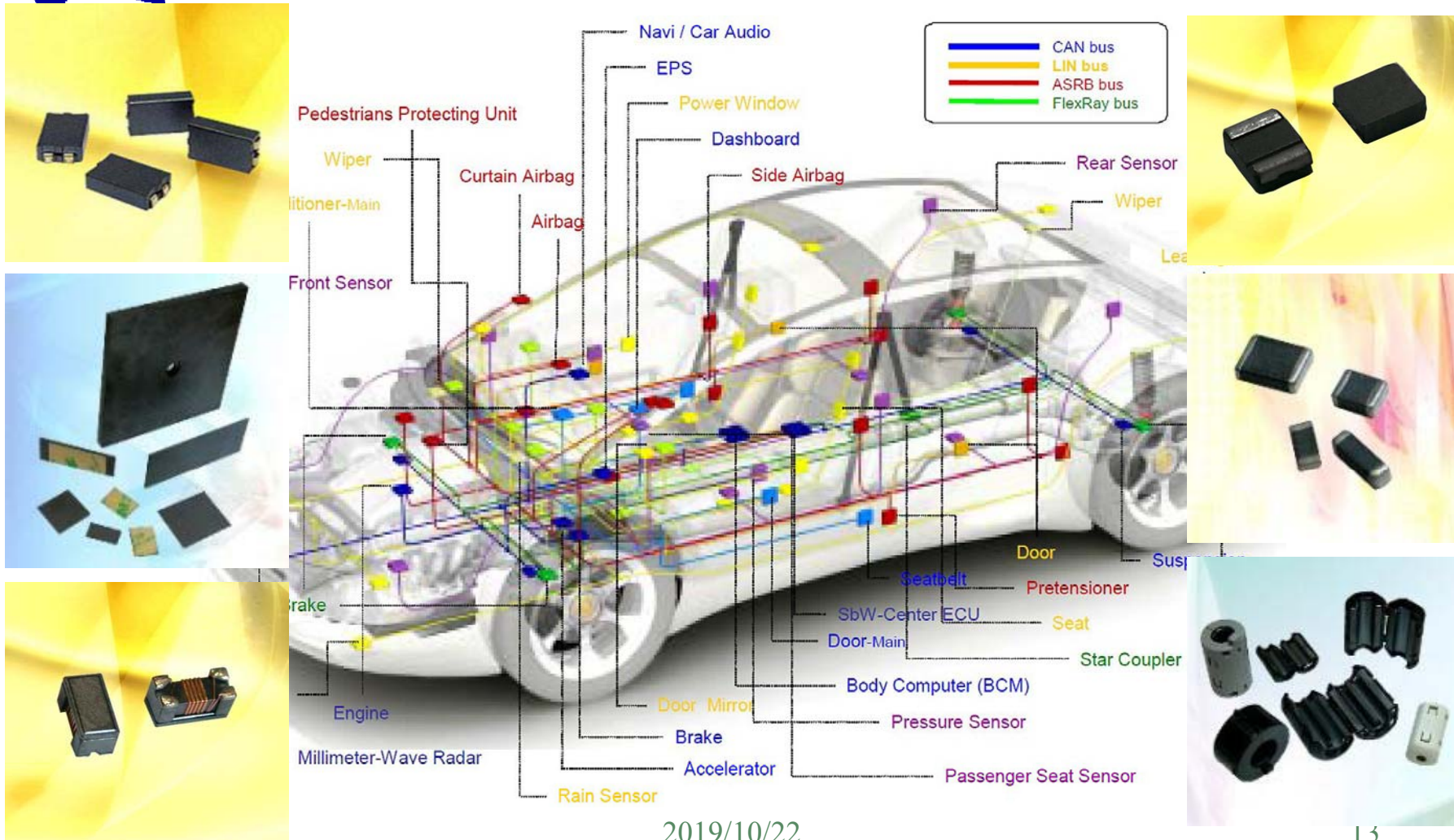


客戶族群佔比

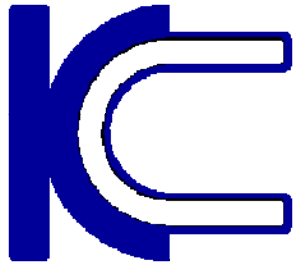




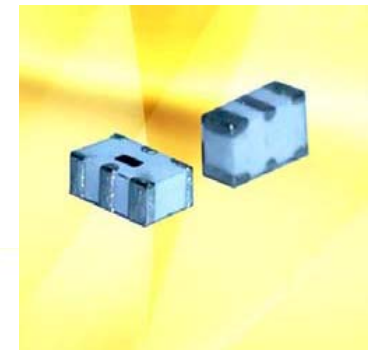
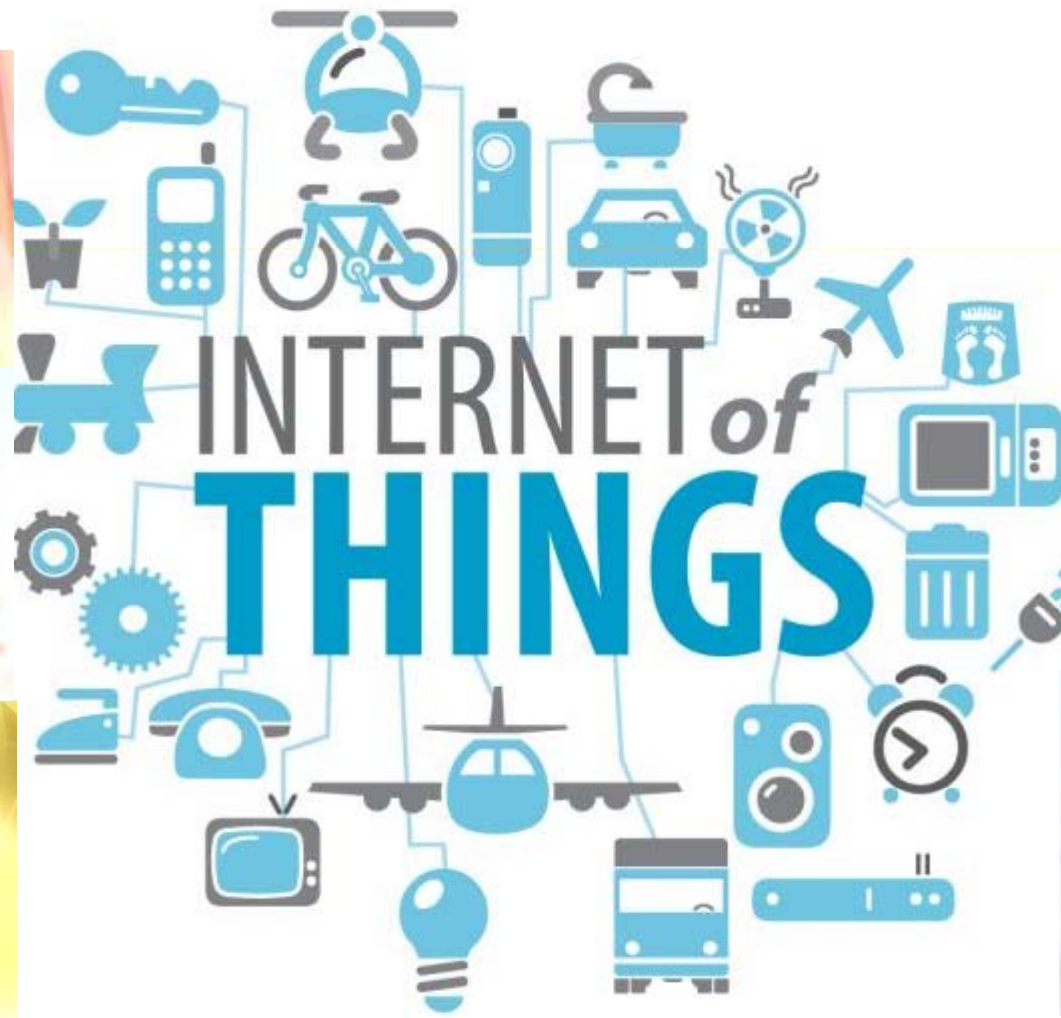
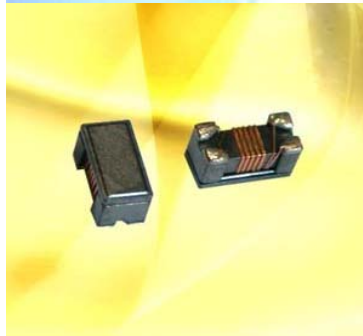
Automobile Electronics Application



2019/10/22

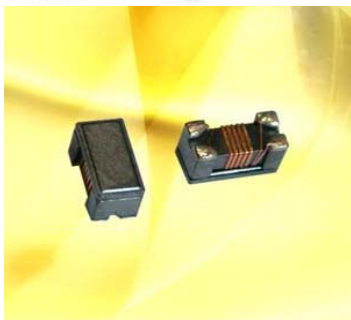
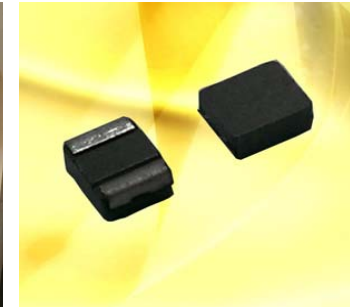


Communication and Network Application





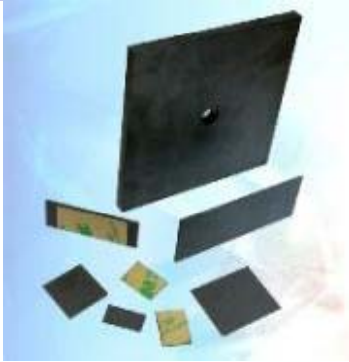
Home Appliances and IPC

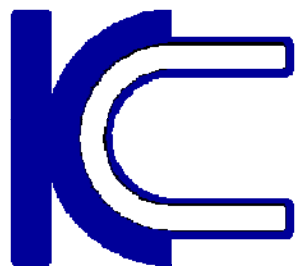


2019/10/22



Power Application



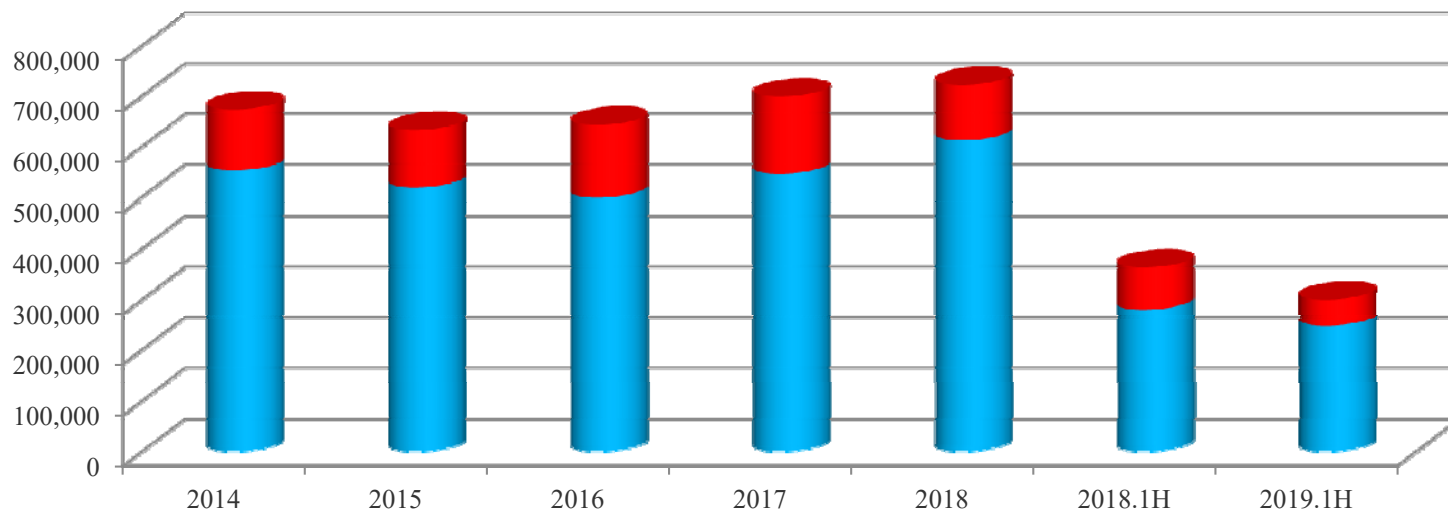


歷年營業金額

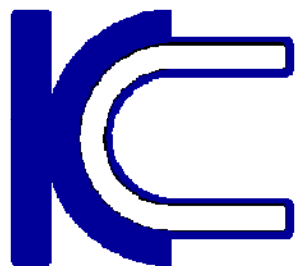
2019.1~9 : 479,005
YoY : -13%

NTD : K

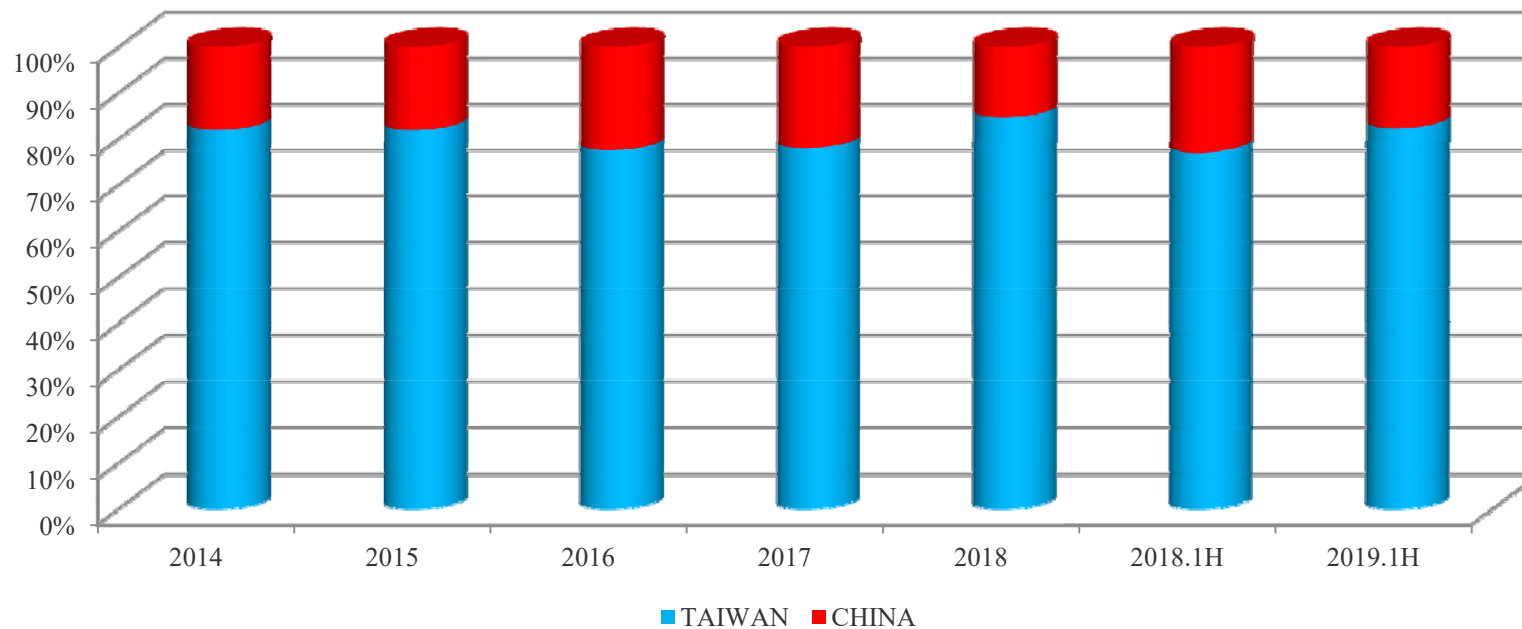
■ TAIWAN ■ CHINA



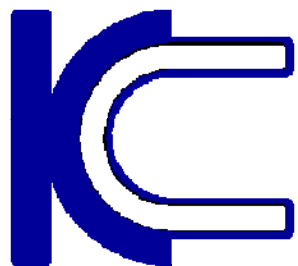
	2014	2015	2016	2017	2018	2019.1H	2019.1~9
Sales	673,016	632,332	642,745	698,467	722,186	299,835	479,005



各廠營收佔比

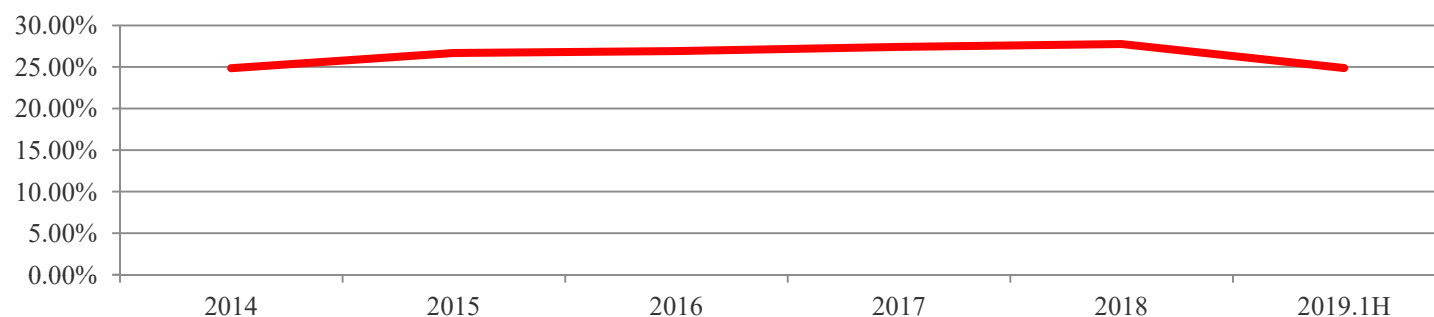


	2014	2015	2016	2017	2018	2018.1H	2019.1H
Taiwan	82%	82%	78%	78%	85%	77%	82%
China	18%	18%	22%	22%	15%	23%	18%



經營實績

Gross Margin(%)



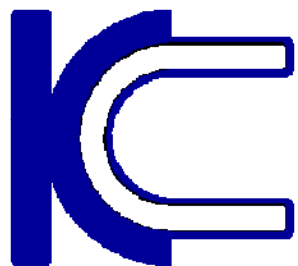
Unit : NTD, K

	2014	2015	2016	2017	2018	2019.1H
Net Revenue	673,016	632,332	642,745	698,467	722,186	299,835
Gross Profit	167,308	168,718	172,964	191,501	200,491	74,604
Gross Margin(%)	24.86%	26.68%	26.91%	27.42%	27.76%	24.88%
Profit before tax	140,547	122,163	98,105	43,480	158,602	69,311
Profit for the period	121,461	104,086	82,557	42,957	127,497	58,901
ROE(%)	8.18	7.05	5.8	3.11	9.24	4.2
EPS (NT Dollar)	1.45	1.22	0.96	0.5	1.48	0.68

Note 1: Above financial information has been audited by CPA.

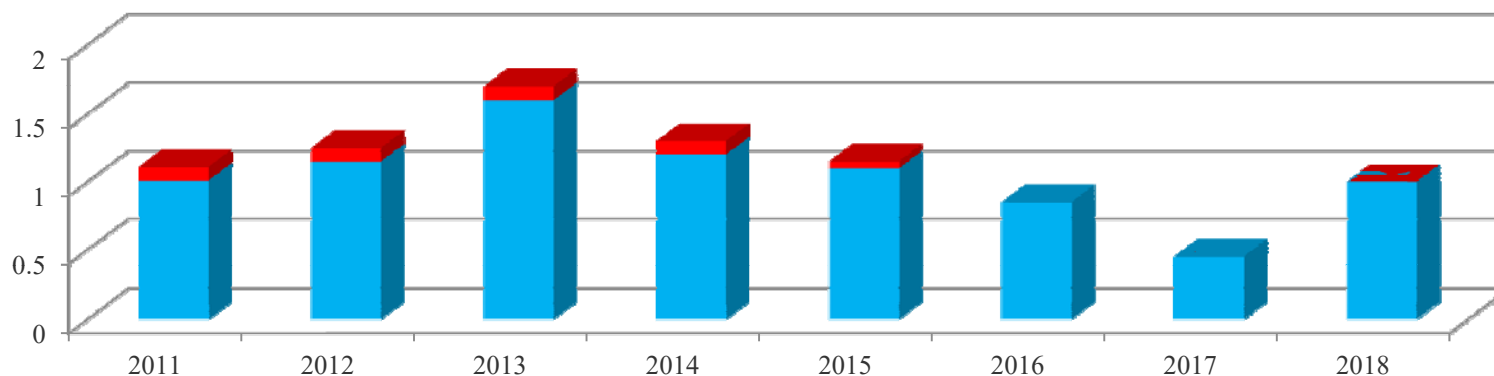
Note 2 : Adopting International Financial Reporting Standards since year 2013.

2019/10/22



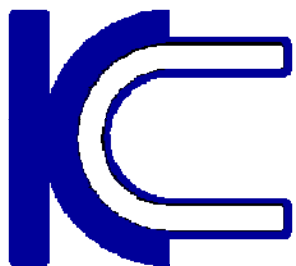
股利發放狀況

■ 每股股利(現金) Dividend(cash) ■ 每股股利(股票) Dividend(stock)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Basic earnings per share (NT Dollar)	0.87	1.4	1.45	1.45	1.22	0.96	0.5	1.48
Dividend (Cash)	1.01	1.15	1.6	1.2	1.1	0.85	0.45	1.0
Dividend (Stock)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0	0	0
Dividend (Total)	1.11	1.25	1.7	1.3	1.15	0.85	0.45	1.0
Payment ratio	127.59%	89.29%	117.24%	89.66%	94.26%	88.43%	90.27%	67.68%

Note :Employee bonus as expenses since year 2008.



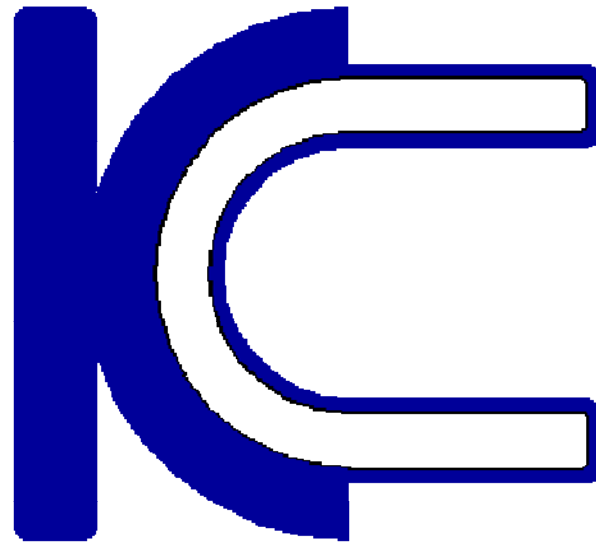
KC Product Development Roadmap

開發產品趨勢	研發技術重點	產品應用市場
GHz Common Mode Filter / Choke	配方研發、精密胚帶、線路設計、精密印刷、疊層、量測、生產技術	5G、高速差模傳輸介面USB 3.1 up 開發之共模濾波器、帶通與低通濾波器及雙工器
GHz 頻率/阻抗抑制 Multilayer chip 設計&材質	配方研發、線路設計、精密印刷、疊層生產技術	5G、GHz 頻率配合開發 chip suppressor 供 EMI/RFI 對策應用
防電磁波干擾之磁性吸波材質	配方研發、成型技術、燒結技術、量測技術	車用電子、5G、電磁波隔離應用 EMI抑制吸收、無線充電及NFC 元件基材使用
耐大電流 Multilayer 積層電感產品	配方研發、線路設計、共燒燒結技術	車用電子、5G、各類電子電機產品，針對各種耐電流需求之電路使用
微型功率電感Power Choke	線路設計、精密線圈技術、粉末壓合、塗佈技術	車用電子、5G、各種小型化、薄型化電子電機產品，大電流微型功率電感需求應用

2019/10/22

21

鈞寶電子工業股份有限公司
KING CORE ELECTRONICS INC.



敬 請 指 導